

Title (en)

WALL COVERING FOR PREVENTING MOULD INFESTATION

Title (de)

WANDBELAG ZUR VERHINDERUNG VON SCHIMMELBEFALL

Title (fr)

REVÊTEMENT MURAL POUR EMPÊCHER L'APPARITION DE MOISSISURE

Publication

**EP 4071318 A1 20221012 (DE)**

Application

**EP 22167724 A 20220411**

Priority

DE 102021108844 A 20210409

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Wandbelag (1) für die bestimmungsgemäß dauerhafte Aufbringung auf einer Hausinnenwand (2a) zur Verhinderung von Schimmelbefall an einem kühlen Wandbereich (5) der Hausinnenwand. Der Wandbelag (1) ist durch ein thermisch leitfähiges Vlies, Gewebe oder eine Beschichtung eines Trägermaterials (8, 9, 10) gebildet, bestehend aus einem Material mit einer Wärmeleitfähigkeit von mehr als 200W/m·K. Der Wandbelag (1) ist nicht-elektrisch und bestimmungsgemäß dafür vorgesehen, derart flächig auf die Hausinnenwand (2a) aufgebracht zu werden, dass er den kühlen Wandbereich (5) als auch einen an den kühlen Wandbereich angrenzenden wärmeren Wandbereich (4) überdeckt und dadurch vom wärmeren Wandbereich (4) Wärme aufnimmt und zum kälteren Wandbereich (5) leitet, um die Oberflächentemperatur des kühlen Wandbereichs (5) um 1-3°C zu erhöhen. Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung des Wandbelags (1) auf der Hausinnenwand (2a), ein Verfahren zu dessen Aufbringung und dessen Verwendung für das erfindungsgemäße Verfahren.

IPC 8 full level

**E04F 13/00** (2006.01); **E04F 13/08** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E04F 13/002** (2013.01); **E04F 13/0866** (2013.01); **E04F 13/0885** (2013.01); **E04F 2290/04** (2013.01)

Citation (search report)

- [XY] WO 2019234809 A1 20191212 - OHGI TECH CREATION CO LTD [JP]
- [Y] CN 108086614 A 20180529 - SHANGHAI APE STONE CO LTD
- [Y] US 2009308001 A1 20091217 - WU SHAOBING [US], et al

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 4071318 A1 20221012**; DE 102021108844 A1 20221013

DOCDB simple family (application)

**EP 22167724 A 20220411**; DE 102021108844 A 20210409